

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：ZSLTC-2025-S163 项目名称：华北电力大学硬件在环仿真项目材料采购项目

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商规模	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	FPGA 高速仿真卡	北京智件科技有限公司	北京/中国	小型企业	xSim	定制	329000	1	329000
2	AD 模拟量采集卡	北京智件科技有限公司	北京/中国	小型企业	xSim	定制	23000	2	46000
3	DA 模拟量输出卡	北京智件科技有限公司	北京/中国	小型企业	xSim	定制	22000	2	44000
4	DIO 数字量采集卡	北京智件科技有限公司	北京/中国	小型企业	xSim	定制	19000	2	38000
5	DIO PWM 数字输入输出卡	北京智件科技有限公司	北京/中国	小型企业	xSim	定制	20000	2	40000
6	实时通信接口卡	北京智件科技有限公司	北京/中国	小型企业	xSim	定制	49800	1	49800
7	机箱及电源	北京智件科技有限公司	北京/中国	小型企业	xSim	定制	0	1	0
8	12 槽背板	北京智件	北京/中	小型企业	xSim	定制	0	1	0

		科技有限公司	国						
9	FPGA 仿真上位机软件	北京智件科技有限公司	北京/中国	小型企业	xSim	定制	0	1	0
10	配件	北京智件科技有限公司	北京/中国	小型企业	xSim	定制	0	8	0
总价（元）									546800

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）北京智件科技有限公司

日期：2025年11月30日

